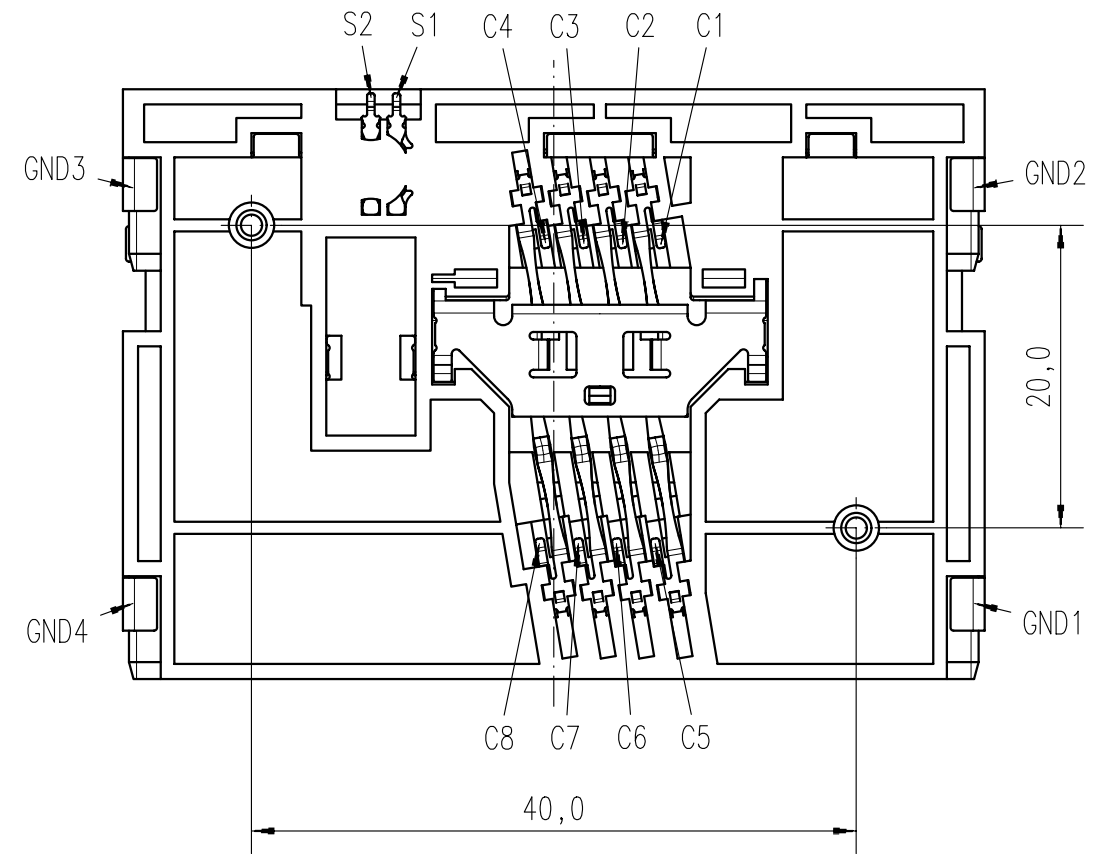
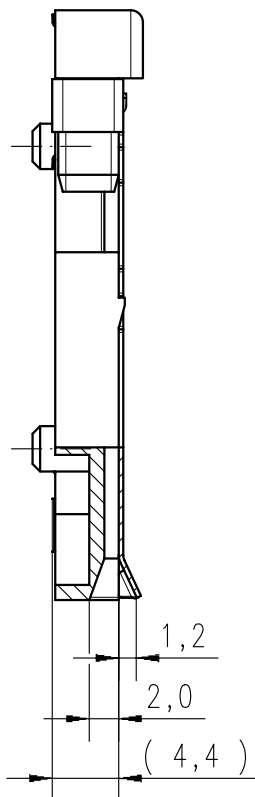
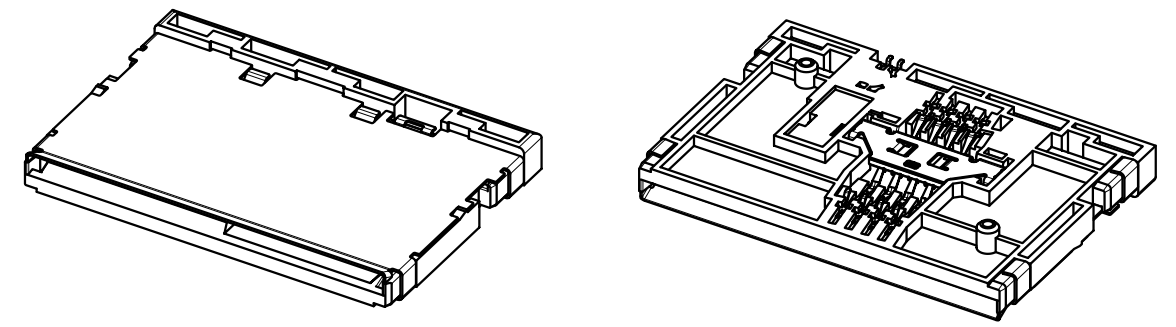
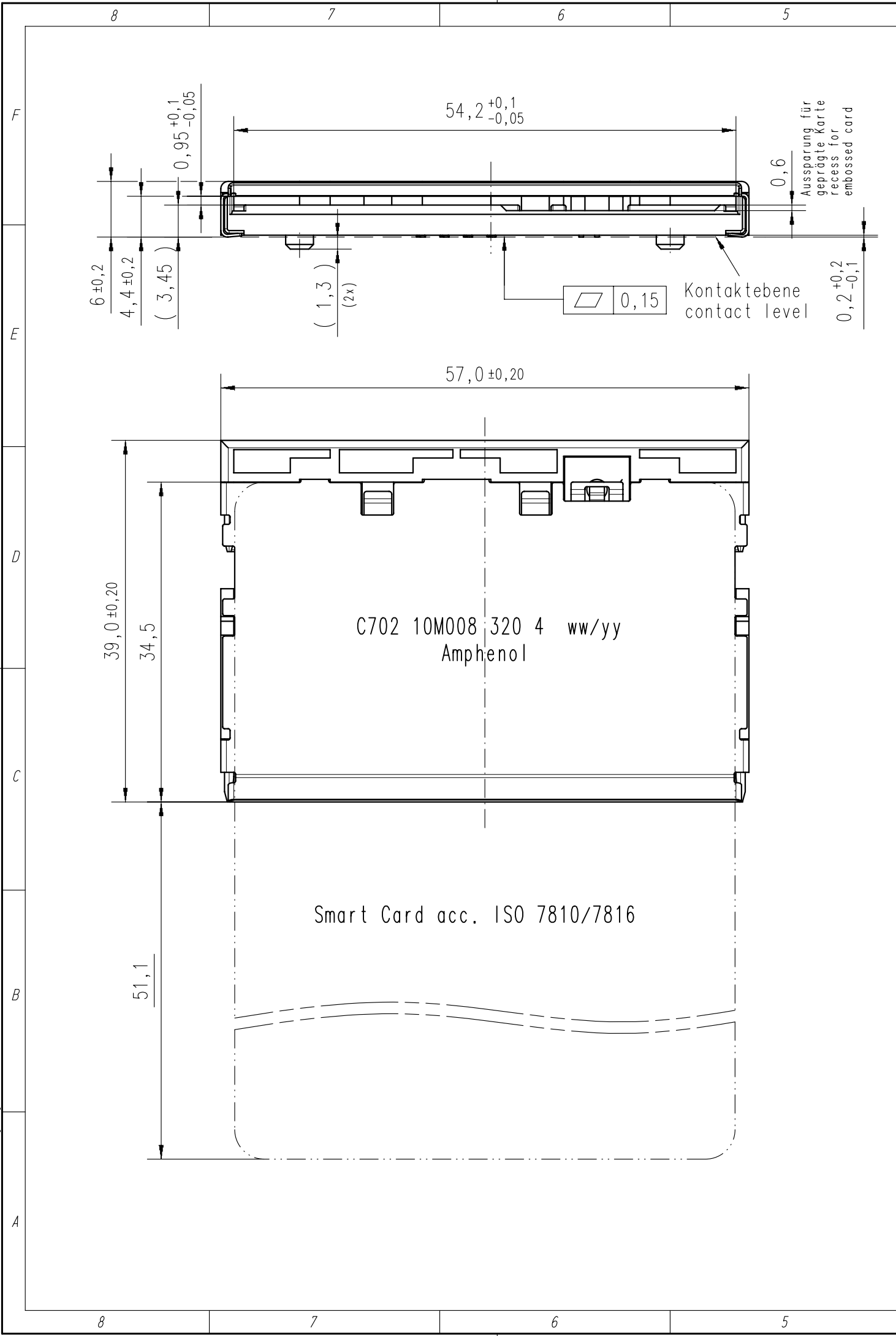


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

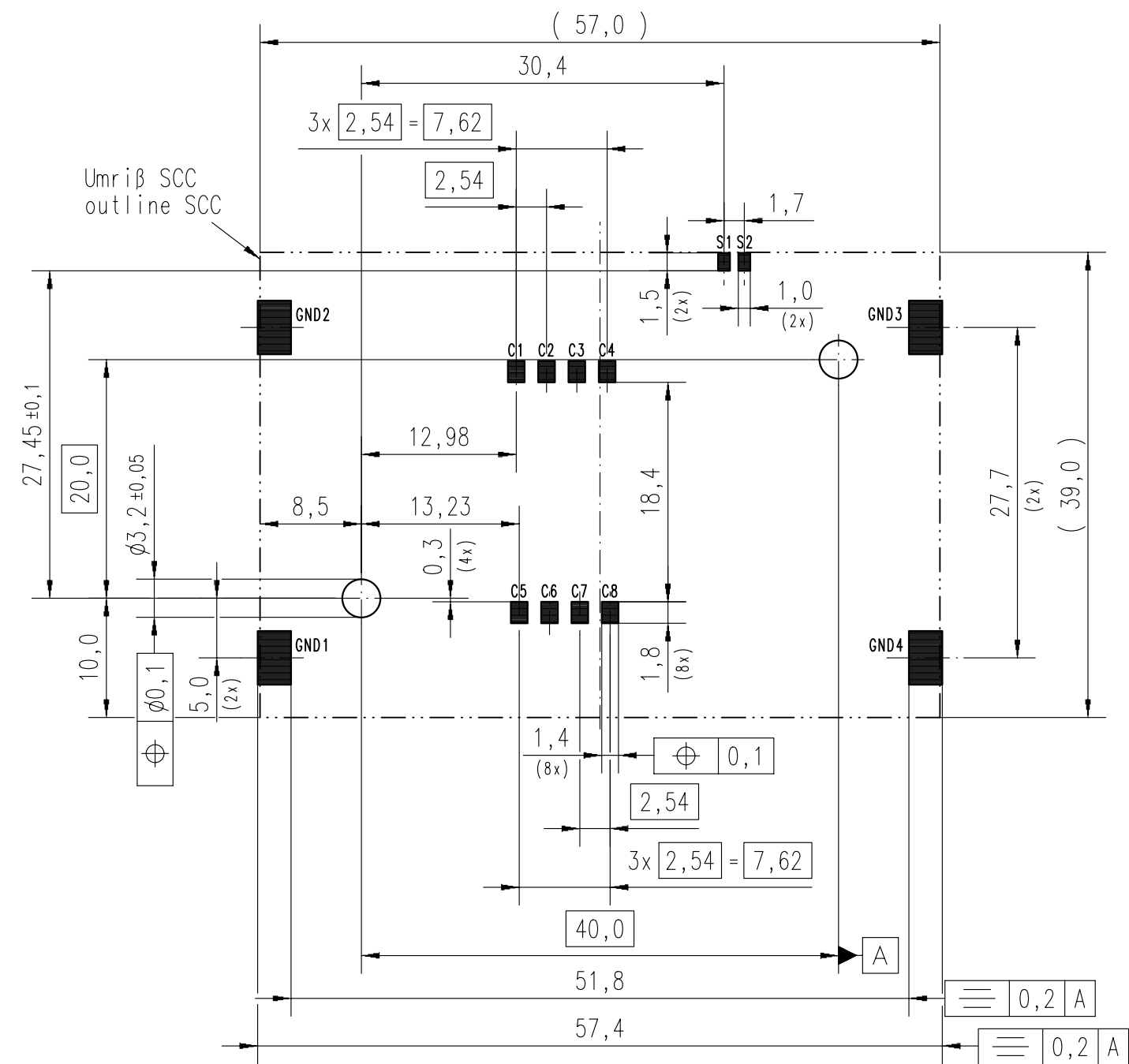


Spezifikation und Leiterplattenlayout siehe Seite 2
 Specification and PCB layout see page 2

Masse (errechnet)/Calc WF: 11,8 ⁹		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1	A3	
Prüfmaß/Testdimension		ISO 2768-mH		CUSTOMER DRAWING		
Teileindex Partindexnumber 02 ⁰³		DIN/ISO 13715		Smart Card Connector push-pull, landing contacts		
		11 Datum/Date Name				
		Gez. 28.07. Bertsch				
		Gepr.				
		Checked				
03	201200737	10.12.12	ToI.	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		
02	201200200	15.03.12	ToI.			
01	201000417	29.07.11	Ber.			
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	Ers. f./Replacement for:		
				M	C702 10M008 320 4	Blatt/Sheet 1 2 Bl.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

vorgeschlagenes Leiterplattenlayout (Bestückungsseite)
proposed PCB layout (component side)



empfohlene Lotpastendicke: 0,18 mm
No-Clean Lötpaste verwenden, Bauteil ist nicht waschbar
recommended solder paste thickness: 0,18 mm
No-Clean solder paste recommended, part is not washable

Kennwerte
Characteristics

DESIGN
type: push-pull, landing contacts
normally open switch
with positioning studs

GENERAL CHARACTERISTICS
number of contacts: 8 contacts
switch: normally open (no card inserted)
card type: according to ISO 7810 / 7816
card thickness: 0,76 ±0,08 mm
termination: SMT

MATERIALS AND PLATING
insulator: LCP, black
contact plating: Au over Ni

CLIMATIC CHARACTERISTICS
operating temperature: -25 °C to +70 °C
storage temperature: -40 °C to +85 °C
soldering process: reflow soldering

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
contact resistance: < 60 mΩ (data contacts)
< 1 Ω (switch)
insulation resistance: >10⁹ Ω
high voltage resistance: 500 V AC for 1 minute
rated voltage: <15 V DC
rated current: <0,5 A

MECHANICAL CHARACTERISTICS
card insertion force: <12 N
⊗ card holding force: >2 N
mechanical lifetime: 500.000 mating cycles
(without corrosion stress)

PACKAGING ⊗ 22 parts per tray
21 trays per carton

ausführliche Spezifikation siehe N 50 702 0053
full specification see N 50 702 0053

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Masse (errechnet)/Calc WT: 11,8 g		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3	
Prüfmaß/Testdimension		ISO 2768-mH		DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING	
Teileindex Partindexnumber 02 [⊗]		11 Datum/Date		Name		Smart Card Connector	
		Gez. 28.07.		Bertsch		push-pull, landing contacts	
		Drawn					
		Gepr.					
		Checked					
03	201200737	10.12.12	ToI.	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		Blatt/Sheet 2	
02	201200200	15.03.12	ToI.			M C702 10M008 320 4	
01	201000417	29.07.11	Ber.			2 Bl.	
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	Ers. f./Replacement for:			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9